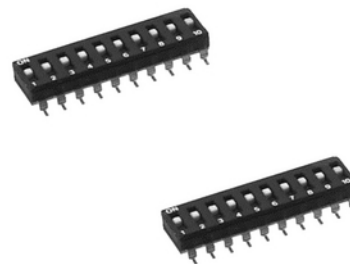


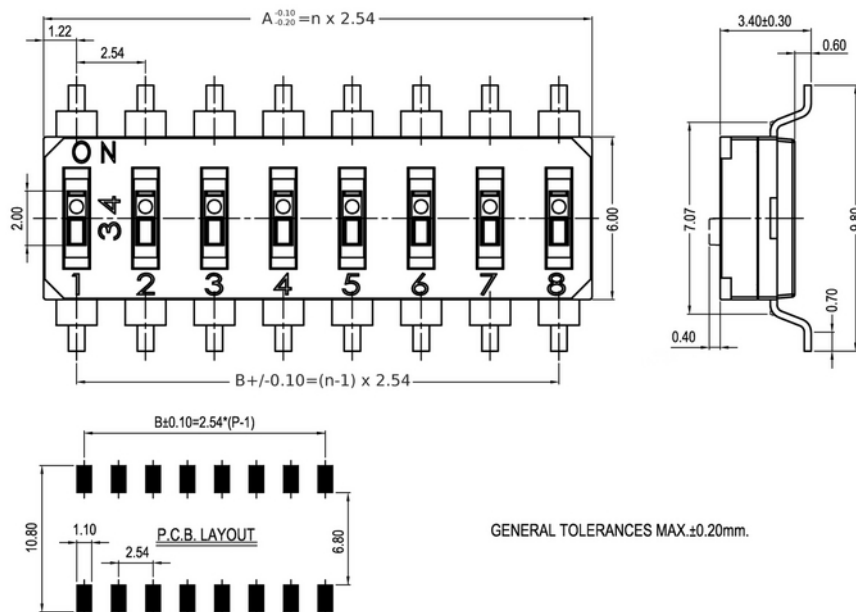
SMT-DIP-Schalter RM 2,54mm - Standard-Version SMT DIP-Switches 2.54mm Pitch - Standard Version

Technische Daten / Technical Data

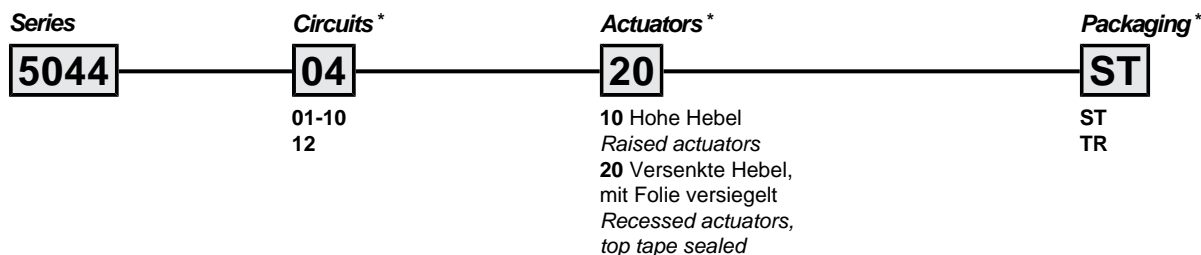
Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Gehäuse: schwarz; Hebel: weiß
Colour	Housing: black; actuator: white
Kontaktmaterial	Messing, vergoldet über Nickel
Contact Material	Brass, gold plated over nickel
Kontaktbelastbarkeit	50V _{DC} , 100mA in Ruhe
Contact Rating	24V _{DC} , 25mA im Schaltvorgang
	50V _{DC} , 100mA in steady situation
	24V _{DC} , 25mA at mate and break
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
	Solderability
Durchgangswiderstand	< 100mΩ im Auslieferungszustand
Contact Resistance	< 100mΩ at initial state
Isolationswiderstand	> 100MΩ
Insulation Resistance	> 100MΩ @ 500V _{DC}
Spannungsfestigkeit	500V _{DC}
Test Voltage	500V _{DC}
Temperaturbereich	-20°C ... +85°C
Temperature Range	-20°C ... +85°C
Elektrische Lebensdauer	min. 2000 Schaltungen/Schalter
Electrical Life	min. 2000 operations/switch
Mechanische Lebensdauer	min. 2000 Schaltungen/Schalter
Mechanical Life	min. 2000 operations/switch
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS



GENERAL TOLERANCES MAX.±0.20mm.



Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad
TR Tape & Reel / Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

